

2004年11月15日

宇部興産株式会社

ポリイミドフィルムの第8期増設を決定

宇部興産株式会社(社長:常見和正)は、このたび、液晶駆動用 IC 実装基材やフレキシブル回路基板(FPC)用に需要伸長の著しいポリイミドフィルム(商品名:「ユーピレックス」)の第8期増設を決定した。

ポリイミドフィルムは、耐熱性に優れ、電子情報関連機器の基板材料などに使用されている。携帯電話、パソコン、デジタル家電などの市場拡大や高機能化に伴い、今後も年率15%以上で需要が拡大すると予測される。

当社のポリイミドフィルムは、抜群の寸法安定性を有することから、LCD(液晶表示装置)分野向けを主体としたTAB(Tape Automated Bonding:IC自動実装方式)用途で圧倒的なシェアを占め、業界標準を確立している。今後液晶パネルの高精細化に伴い同分野で伸長すると予想されるCOF(チップ・オン・フィルム)用途においても、ユーザーから高い評価を獲得している。

また、モバイル機器やデジタル家電の市場拡大および高機能化により、フレキシブル銅張積層板(2層CCL)用ベースフィルムとしての需要も大幅な増加が見込まれる。

さらに、FPC分野においては、多層化やモジュール化が進むため、寸法安定性に優れ、適度な弾性率を持つ「ユーピレックス」への期待が高まっている。

昨年12月に第7期設備が稼動したが、旺盛な需要により、既にフル生産状態となっている。今後の更なる需要増に対応するために、積極的に生産能力を増強し、安定供給に努める必要があると判断し、山口県宇部市のケミカル工場内に第8期設備を増設することを決定した。完成は2006年夏を予定しており、稼動後は生産能力が現行の3割増となる。

当社では、ポリイミド事業を含む機能性材料事業をコア事業のひとつと位置づけ、積極的な業容の拡大を図っている。ポリイミドの原料モノマーやワニスの販売、またポリイミドフィルムの川下分野として2層CCLやCOFを事業展開している。さらに、航空宇宙用途での高耐熱複合材料用付加型ポリイミドや熱制御フィルム、ポリイミド多孔質膜など新規事業展開にも注力している。

本件に関するお問合せ先

宇部興産株式会社 IR広報部

〒105 8449 東京都港区芝浦一丁目2番1号 シーバンスN館

TEL : 03-5419-6110

以上